(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
10. Januar 2013 (10.01.2013)

WIPO | PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2013/003877 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:
H01L 21/683 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/AT2012/050092

(22) Internationales Anmeldedatum:
2. Juli 2012 (02.07.2012)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
A 969/2011 1. Juli 2011 (01.07.2011) AT

(71) Anmelder *(für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US)*: **MECHATRONIC SYSTEMTECHNIK GMBH** [AT/AT]; Tiroler Straße 80, A-9500 Villach (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder *(nur für US)*: **OREMUS, Alexander** [AT/AT]; Falkenweg 17, A-9500 Villach (AT).

(74) Anwalt: **JELL, Friedrich**; Bismarckstraße 9, A-4020 Linz (AT).

(81) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare nationale Schutzrechtsart)*: AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten *(soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart)*: ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

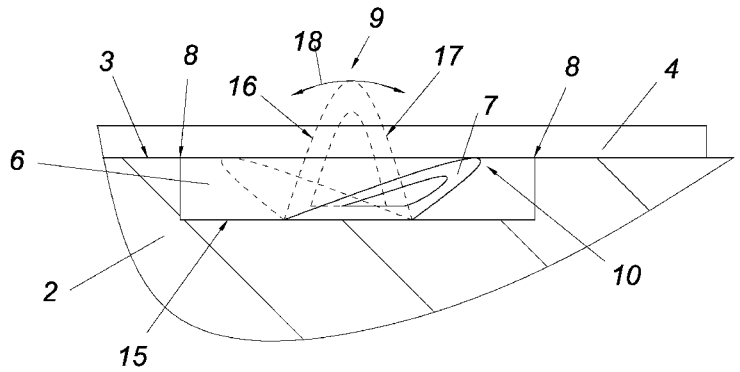
Veröffentlicht:

— *mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz 3)*

(54) Title: DEVICE FOR HOLDING A PLANAR SUBSTRATE

(54) Bezeichnung : VORRICHTUNG ZUM HALTEN EINES FLÄCHIGEN SUBSTRATS

FIG.2



(57) Abstract: A device (1) for holding a planar substrate (4), in particular for a wafer or an eWLB, is shown, with a support (2) which forms a supporting surface (3) for the substrate (2) and has at least one recess (5) provided in the region of the supporting surface (3) for the substrate (2), and with at least one holding means which is connected in terms of flow to said recess (6) and is intended for fixing the substrate (2) on the device (1) with the aid of a vacuum generated between the support (2) and substrate (4). In order to be able to grip a multiplicity of substrates of geometrically differing profile, it is proposed that the support (2) has at least one recess (6) with an elastic seal (7) which is designed to be movable from a position (9) protruding over the edge (8) of the recess (6) into a position (10) pulled back in relation to the edge (8) of the recess (6) or at most corresponding to said edge and which interacts with the recess (5) for sucking the full area of the substrate (4) onto the support (2).

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2013/003877 A1